



ロジャース高周波基板材料ラインナップ

( はボンディングフィルムもしくはプリプレグ)

	製品名	誘電率 @ 10GHz	誘電正接 @ 10GHz	熱伝導率 W/m/K	熱膨張係数 Z方向 ppm/°C	吸水率 %	ピール強度 N/mm	難燃性
高信頼性 PTFE 高周波基板材料	RT/duroid®5870	2.33±0.02	0.0012	0.22	173	0.02	4.8	94V-0
	RT/duroid®5880	2.20±0.02	0.0009	0.20	237	0.02	5.5	94V-0
	RT/duroid®5880LZ	1.96±0.04	0.0019	0.33	41	0.22	>0.7	94V-0
	RT/duroid®6002	2.94±0.04	0.0012	0.60	24	0.02	1.6	94V-0
	RT/duroid®6202	2.94-3.06±0.04	0.0015	0.68	30	0.1	1.6	94V-0
	RT/duroid®6202PR	2.90-2.98±0.04	0.0020	0.68	30	0.1	2.5	94V-0
	RT/duroid®6035HTC	3.50±0.05	0.0013	1.44	39	0.06	1.4	94V-0
	RT/duroid®6010LM	10.20±0.25	0.0023	0.86	47	0.01	2.1	94V-0
	3001 Bonding Film	2.28	0.003	0.22	-	0.05	-	N/A
高信頼性 熱硬化性樹脂 高周波基板材料	TMM™ 3	3.27±0.032	0.0020	0.70	23	0.06	1.0	N/A
	TMM™ 4	4.50±0.045	0.0020	0.70	21	0.07	1.0	N/A
	TMM™ 6	6.00±0.08	0.0023	0.72	26	0.06	1.0	N/A
	TMM™ 10	9.20±0.23	0.0022	0.76	20	0.09	0.9	N/A
	TMM™ 10i	9.80±0.245	0.0020	0.76	20	0.16	0.9	N/A
汎用タイプ PTFE 高周波基板材料	RO3003™	3.00±0.04	0.0010	0.50	25	0.04	2.2	94V-0
	RO3006™	6.15±0.15	0.0020	0.79	24	0.02	1.2	94V-0
	RO3010™	10.20±0.30	0.0022	0.95	16	0.05	1.6	94V-0
	RO3035™	3.50±0.05	0.0015	0.50	24	0.04	1.6	94V-0
	RO3203™	3.02±0.04	0.0016	0.48	58	<0.1	1.8	94V-0
	RO3206™	6.15±0.15	0.0027	0.67	34	<0.1	1.9	94V-0
	RO3210™	10.20±0.50	0.0027	0.81	34	<0.1	1.9	94V-0
	RO3003™ Bond-ply	3.00±0.04	0.0013	0.50	15	0.04	-	94V-0
	RO3006™ Bond-ply	6.15±0.15	0.0020	0.79	24	0.02	-	94V-0
	RO3010™ Bond-ply	10.20±0.30	0.0022	0.95	16	0.05	-	94V-0
汎用タイプ 熱硬化性樹脂 高周波基板材料	RO4003C™	3.38±0.05	0.0027	0.71	46	0.06	1.05	N/A
	RO4350B™	3.48±0.05	0.0037	0.69	32	0.06	0.88	94V-0
	RO4835™	3.48±0.05	0.0037	0.66	31	0.05	0.88	94V-0
	RO4360G2™	6.15±0.15	0.0038	0.75	28	0.08	0.91	94V-0
	RO4450B™	3.54±0.05	0.004	0.60	50	0.05	-	94V-0
	RO4450F™	3.52±0.05	0.004	0.65	50	0.09	-	94V-0
基地局アンテナ用 熱硬化性樹脂 高周波基板材料	RO4725JXR™	2.55±0.05	0.0026	0.38	26	0.24	1.49	N/A
	RO4730JXR™	3.00±0.05	0.0027	0.49	21	0.14	1.47	N/A
	RO4533™	3.30±0.08	0.0025	0.60	37	0.02	0.9	N/A
	RO4534™	3.40±0.08	0.0027	0.60	46	0.06	1.0	N/A
	RO4535™	3.50±0.08	0.0037	0.60	35	0.05	0.9	94V-0
PEEK 基板材料	XT/duroid™ 8000	3.23±0.05	0.0035	0.35	68	0.20	0.88	VTM-0
	XT/duroid™ 8100 (2 / 4 mil)	3.54 / 3.32±0.05	0.0049	0.3	57 / 76	0.32	1.1	VTM-0
その他 基板材料	ULTRALAM®3850 (LCP)	2.90	0.0025	0.20	150	0.04	0.95	VTM-0
	ULTRALAM®3908 (LCP)	2.90	0.0025	0.20	150	0.04	-	VTM-0
	2929 Bondply	2.94±0.05	0.003	0.4	50	0.1	-	NA

本資料は参考のため、詳細な特性、測定方法やその他詳しい情報などは製品個別カタログをご参照もしくは当社までお問い合わせをお願い申し上げます。RT62xx, RO32xx はガラスクロス入り PTFE 樹脂基板材料になります。

製品誘電体厚みラインナップ

( はボンディングフィルムもしくはプリプレグ)

製品	誘電体厚み (mm)	製品	誘電体厚み (mm)
RT/duroid®5870, 5880	0.127 / 0.254 / 0.381 / 0.508 / 0.787 / 1.575 / 3.175	RO3003™, RO3035™ *RO3203™	0.127 / *0.254 / *0.508 / *0.762 / *1.524
RT/duroid®5880LZ	0.254 / 0.508 / 0.635 / 0.762 / 1.026 / 1.270 / 2.540	RO3006™, RO3010™, *RO3206™, *RO3210™	0.127 / 0.254 / *0.635 / *1.27
RT/duroid®6002, 6202	0.127 / 0.254 / 0.508 / 0.762 / 1.524	RO3003™ Bond-ply, RO3006™ Bond-ply, RO3010™ Bond-ply	0.127
RT/duroid®6202PR	0.127 / 0.254 / 0.508		
RT/duroid®6035HTC	0.254 / 0.508 / 0.762 / 1.524	RO4003C™, RO4360G2™	0.203 / 0.305 / 0.406 / 0.508 / 0.813 / 1.524
RT/duroid®6010LM	0.127 / 0.254 / 0.635 / 1.270 / 1.905 / 2.540	RO4350B™, RO4835™	0.101 / 0.168 / 0.254 / 0.338 / 0.422 / 0.508 / 0.762 / 1.524
3001 Bonding Film	0.038		
2929 Bondply	0.038 / 0.051 / 0.076		
TMM™3, 4, 6, 10, 10i	0.381 / 0.508 / 0.635 / 0.762 / 1.270 / 1.524 / 3.175 ~ 12.70	RO4450B™ RO4450F™	0.091 / 0.101
XT/duroid™8000	0.051	RO4725JXR™ *RO4730JXR™	0.762 / *1.034 / 1.524
XT/duroid™8100	0.051 / 0.101		
ULTRALAM®3850	0.025 / 0.05 / 0.1	RO4533™, RO4535™	0.762 / 1.016 / 1.524
ULTRALAM®3908	0.025 / 0.05	RO4534™	0.813 / 1.016 / 1.524

RT/duroid®シリーズ, TMM™シリーズ及び RO3000™シリーズについては、カスタム厚みも対応しております。

銅箔およびメタルオプションについて

基本的に両面 1/2Oz, 1Oz, 2Oz の電解銅箔になります。

RT/duroid®シリーズについては、オプションとして銅箔無し/厚銅/アルミ/真鍮/圧延銅箔付きも対応しており、銅箔は 1/4Oz も一部厚みで対応しております

RT/duroid®6202PR は平面抵抗(Planar Resistor)層のある製品により、購入時と加工後では抵抗値が異なる可能性があります。

RO3000™シリーズでは、圧延銅箔 1/2Oz, 1Oz, 2Oz も対応しております。また RO3003 厚み 0.127mm は片面 6Oz と 0.040 インチ厚みの圧延銅オプションも対応しております。

RO4000™シリーズはオプションとして LoPro® (ロープロファイル銅箔)も対応しております。(RO4360G2, RO4535 は LoPro®不可) 不明な点は当社へご相談もしくはカタログを参照お願い致します。

テクニカルサポートハブ(本社 Web ページ)

アカウント登録の上、高周波基板設計に役立つ当社独自の資料及び設計補助ツールなどを閲覧及びダウンロード出来るようになります。



アプリケーション例

RT/duroid5000, 6000, TMM シリーズ

- + アンテナ/レーダーシステム/パワー
アンプなどの航空宇宙/衛星通信/
防衛用途
- + 高周波測定装置
- + フィルター、カプラー用途
- + 高周波デバイス/回路研究用基板
- + 準ミリ波、ミリ波帯域の用途など

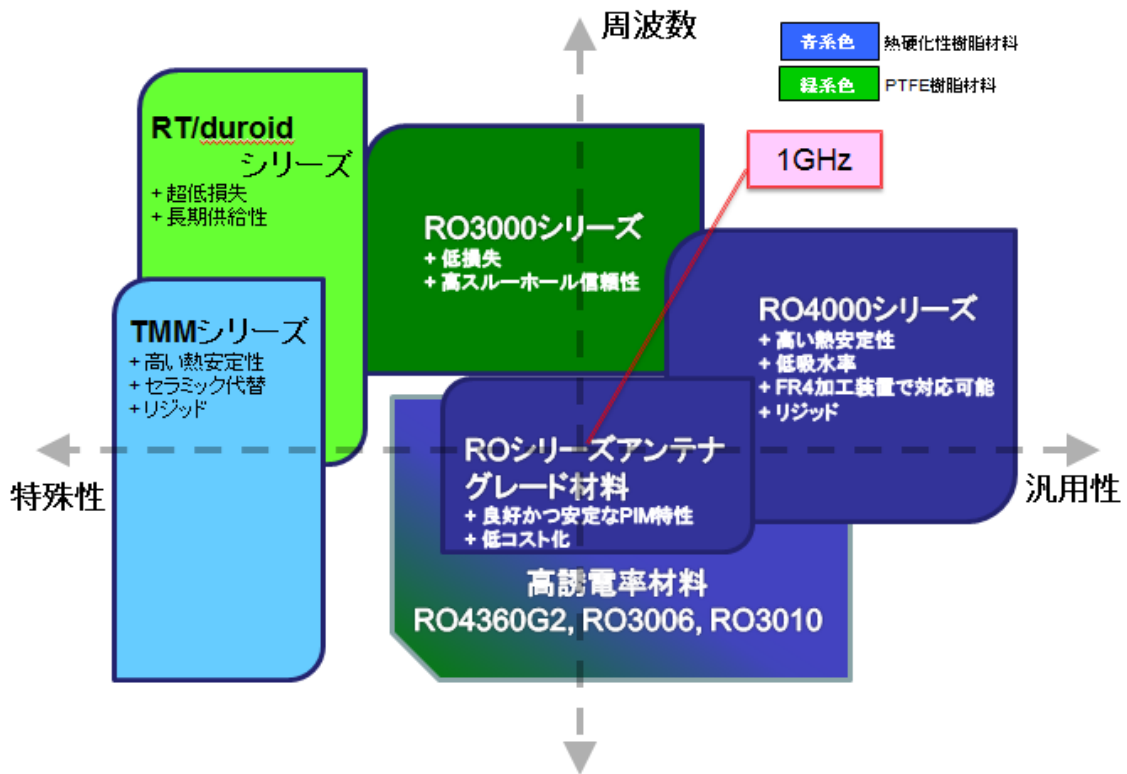
RO3000/RO4000 シリーズ

- + 基地局用パワーアンプ
- + 基地局用アンテナ
- + 車載衝突防止レーダー
- + 計測器・サーバー・ルーター
- + チップパッケージ
- + 衛星用コンバーター
- + RFID アンテナ
- + 準ミリ波、ミリ波帯域の用途など

LCP, XT/duroid シリーズ

- + 車載、航空、宇宙用途の基板
- + チップパッケージ
- + RFID アンテナ、車載用センサー
- + 半導体用バーンインボード
- + 高速通信用ケーブル
- + 高耐熱用基板
- + 雷、オイル、薬品に対する保護
フィルム

製品カテゴリーイメージ (参考)



その他、吸水率が小さかつ周波数に寄らず損失が一定した LCP 材料の ULTRALAM3000 シリーズや、最大動作温度 210°C程
度の薄い耐熱性兼耐薬品性のある PEEK 材料 XT/duroid™8000 シリーズも取り揃えております。